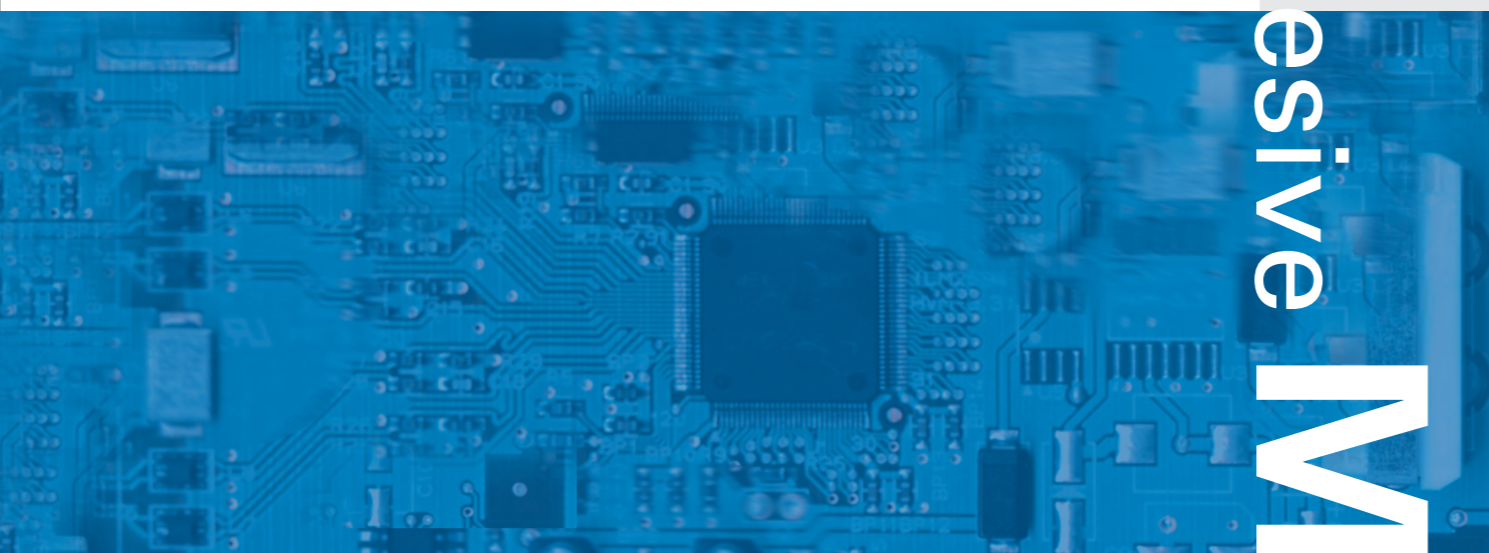


MAX102

低温硬化型 金属接着剤

超熱伝導性・導電性・耐紫外線性

- 優れた熱伝導性、導電性、高耐熱性と耐紫外線性を有する一液性の金属系接着剤です。
- 転写性と吐出性を向上させ、LEDやレーザーダイオードなど微小チップのダイボンド用途への適性を高めました。



● 製品の特長

低温硬化性	ペースト状から180°C以上の加熱で金属に変化
高熱伝導性	213W/m・K
低熱抵抗	0.03°C/W以下 (BLT=10μm)
高電導性	1×10 ⁶ Ω・cmレベル
高融点	900°C以上 (リフロー加熱で再熔融なし)
引張強度	62MPa
ヤング率	14.8GPa
熱膨張率	19ppm
耐紫外線性	紫外線による分解、変色なし
接着性	貴金属 (金、銀、パラジウム、白金) に強固に接着
低汚染性	アウトガス汚染なし・フラックス分未使用につき洗浄不要
厚膜形成が可能	10mm以上の厚膜形成も可能
保存安定性	常温25°C以下保管で3ヶ月以上

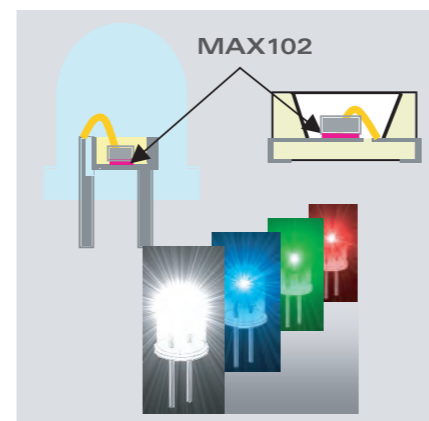
Metal Adhesive MAX102

MAX102

低温硬化型 金属接着剤

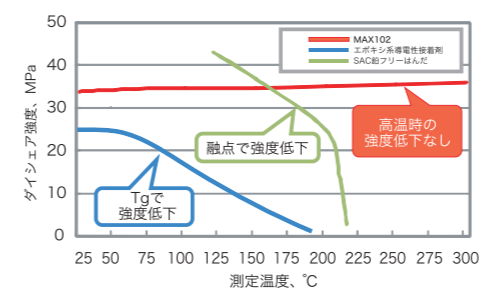
超熱伝導性・導電性・耐紫外線性

推奨用途 優れた転写性、吐出性、熱伝導性、高耐熱性、導電性、耐紫外線性、アウトガスがないこと等の特長を生かした用途として次のような例があります。

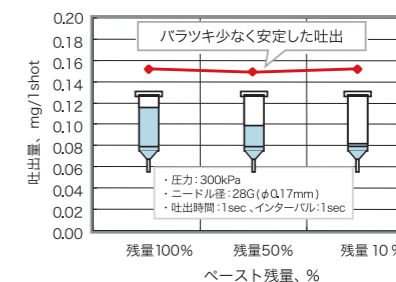


- **ダイボンド剤**
 - LED、レーザーダイオード
 - 良好な転写性・吐出性
 - 紫外線・熱による劣化がなく放熱にも有効
 - 樹脂封止型半導体部品
 - アウトガス汚染による接着不良防止
- **放熱用途**
 - MPUの半導体素子と放熱基板の接合
 - パワーデバイスとリードフレーム、放熱基板の接合
 - モジュール (電力素子基板、LED照明)
- **導電用途**
 - フリップチップのバンパ形成
 - 基板のスルーホール充填

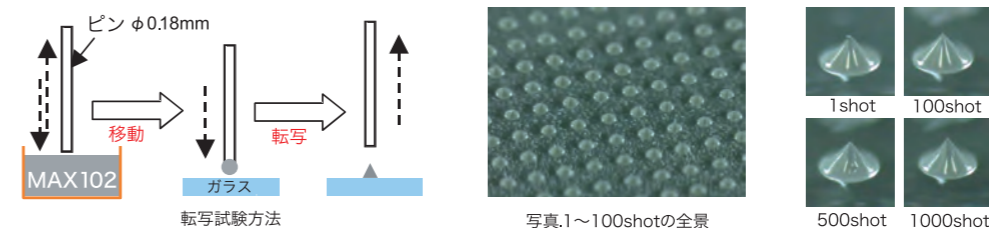
高温時の強度低下がありません



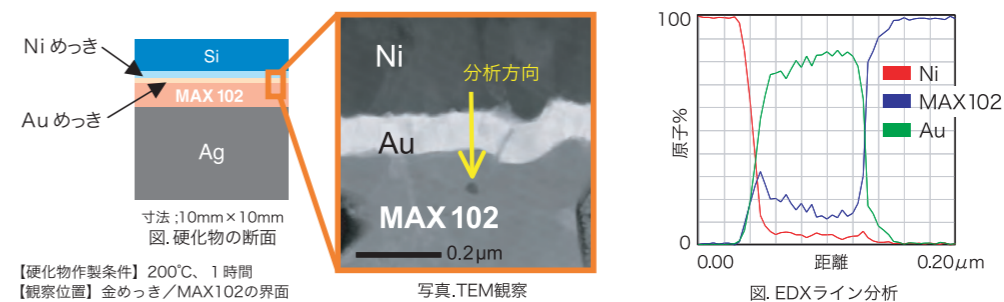
微小吐出が可能です



安定した微小ピン転写が可能です



信頼性の高い金属接合を形成します



※この製品は日本データマテリアル株式会社が製造しています。